

BGA-維修設備

BU-560-錫球植入機-規格

植球能力 $0.35\Phi \sim 0.76\Phi$

- (1)外部尺寸 :75cm(L),X 25cm(W),X 26cm(H)
- (2)重 量 : 32 kg.
- (3)使用電壓 : 110/220V 50/60Hz.
- (4)使用氣壓 : 6 kg/cm².
- (5)錫球規格 :依 BGA 不同使用錫球規格而異.
- (6)BGA 模具 :依 BGA 不同規格 SIZE 可更換需求 BGA 模具.
- (7) BGA 模具 :依 BGA 不同規格 SIZE 可更換需求錫球模具模具.
- (8)錫球植入速度: 錫球植入 BGA-PAD 點可微調控制錫球植入速度.
- (9)錫球植入率:百分之 98
- (10)錫球植入精度:0.03 mm.
- (11)模具槽退料:退料速度 30 - 300 mm/S.
- (12)自動植球時間:22/sec

BGA 再造

~以低廉錫球,重新植入再造完整 BGA~

錫球植入機,將拆下 BGA 重新植入全新錫球,以利重新迴焊維修,本設備提供 SMT 業界進入 BGA 作業技術層次的提昇,本機為 BGA 生產作業得力助手.

本設備榮獲多國專利仿冒必究

***** 維修技術-版權所有禁止翻印-威達誠-技術部提供*****